

第47回セミナー「半導体パッケージ・MEMS 開発の最新動向」(10月6日開催)
参加申込書 (fax-03-5310-2011)

氏名 (フリガナ)	
会員の種別 (該当に○を)	(会員の方は会員番号を記入してください) 正会員 (No. _____) 正会員 (大学・公立研究機関所属者) (No. _____) 賛助会員 (No. _____) 非会員 学生
所属社名・学校名	(社名・部署名、学校名・学部,学科名まで記入してください)
連絡先	所属先・自宅 (以下の記入が所属先か自宅かを○してください) 〒 _____ 電話番号 _____ FAX _____ E メールアドレス _____

問い合わせ先: (社) エレクトロニクス実装学会 第47回セミナー係り

TEL : 03-5310-2010